

证券代码：688261

证券简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023 年第三季度业绩说明会)

编号：IR2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者
会议地点	价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动
上市公司接待人员姓名	龚轶（董事长兼总经理）、李麟（董事兼董事会秘书）、谢长勇（财务负责人）、毕嘉露（独立董事）
交流时间	2023 年 11 月 16 日 15:00-16:00
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：您好，公司对华为的供货品类具体有哪些？是否对华为手机快充等供货？谢谢。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！客户信息涉及公司商业秘密，具体情况不便透露，请谅解。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题二：请问董事长公司四季度订单情况如何？相比较第三季度的业绩下滑是改善还是持续下滑？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2023 年第四季度业绩相关情况请以公司后续披露的定期报告及临时公告</p>

为准。感谢您对公司的关注！

问题三：公司的研发经费的投入情况？公司高管的薪酬如何？分红计划如何？

答：尊敬的投资者您好！2023年1至9月份，公司研发投入为5,983万元，较上年同期增长65.85%；公司将于定期报告中及时披露高管薪酬，请后续关注；公司重视投资者的合理回报需要，并兼顾公司长远利益和可持续发展，尽可能保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，积极采取现金方式分配利润。感谢您对公司的关注！

问题四：请问海外功率半导体龙头厂商加大中国市场竞争力度和下游需求弱复苏双重影响，公司如何调整产品结构差异化？

答：尊敬的投资者您好！为应对未来更加复杂的市场变化，公司将根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新。技术创新能为企业创造出更加明显的边际价值贡献，助力企业穿越半导体行业周期，进一步规避市场波动带来的经营稳定性风险。同时，公司也将积极探索上下游资源整合的路径，持续加大研发投入，根据合作伙伴的制造能力进行深度定制化开发适配的工艺及产品，稳步推进新产品开发，提升产品性能，丰富产品品类与产品规格，不断满足客户对高性能功率半导体产品的需求。感谢您对公司的关注！

问题五：公司高压超级结 MOSFET 第五代试产处于

什么交付阶段？该项目交付完成的收益预期？

答：尊敬的投资者您好！公司第五代超级结 MOSFET 技术研发进展顺利，试产成功且客户试用结果良好，已小批量交付。基于第四、第五代高压超级结技术，单晶圆产出芯片颗数进一步提高，性能得到大幅提升，作为公司核心产品之一将对公司营收提供持续推动力。感谢您对公司的关注！

问题六：公司对产品价格进行了下调的原因？是否是基于外部竞争压力导致？

答：尊敬的投资者您好！进入 2023 年，因功率半导体海外龙头厂商加大中国市场竞争力度、国内产能的进一步释放以及下游需求的调整引致供求关系变化，半导体行业进入下行周期，产品价格呈现明显下降趋势，给国内众多公司相关产品持续的市场化推广带来较大压力，公司对相关产品价格进行了下调，以便更好的适应市场。感谢您对公司的关注！

问题七：公司回购不低于 2500 万元且不超过 5000 万元公司股份主要目的？股权激励的员工持股计划如何？

答：尊敬的投资者您好！股份回购总额是公司在综合考虑了发展现状及未来发展资金需求等因素，满足公司正常生产经营资金需求的前提下，兼顾公司长远利益和可持续发展，由公司实际控制人之一、董事长兼总经理龚轶先生提出的。基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，目的是为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信

心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。感谢您对公司的关注！

问题八：您好董秘，想知道未来市场是否还聚焦在汽车及工业市场，布局上有何新的调整？

答：尊敬的投资者您好！未来公司将继续深耕以光伏逆变及储能、新能源汽车直流充电桩、车载充电机、5G 基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工业照明电源等为代表的工业级与汽车级应用领域，长期与上述领域头部厂商保持稳定、持续的战略合作关系。公司积极布局第三代功率半导体器件，进一步加大第三代半导体、第四代半导体材料等前瞻性研发投入，减小对单一市场及单一产品的依赖性。公司将在巩固现有业务与市场的基础上，加大市场开拓力度，完善业务布局。感谢您对公司的关注！

问题九：面对公司产品结构单一的风险公司如何应对？目前是否有新产品的研发在进一步布局？

答：尊敬的投资者您好！公司功率器件的产品规格丰富，不同规格的产品被应用于不同的应用场景，截止 2023 年 6 月 30 日，公司共计拥有产品规格型号 2,700 余款，随着新产品的持续研发，产品规格型号也将进一步拓展。公司持续进行新产品、新技术的开发工作，遵循技术路线图加速推进各项技术迭代，主营产品从 8 英寸转 12 英寸工艺平台的拓展工作已经基本完成，为工艺技术的继续迭代和交

	<p>付能力提供了坚实的基础。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题十：董秘您好，请问贵司开发出具有自主知识产权的 Si2CMOSFET 的出货情况，交付处于什么阶段？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！截至 2023 年三季度，公司 Si2C MOSFET 已经通过客户测试验证并实现批量供货，应用领域包括新能源汽车车载充电机、光伏逆变及储能、高效率通信电源、数据中心服务器高效率电源等。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题十一：目前公司主要是以境内营收为主，公司是否会积极加大海外市场布局？目前在欧洲市场布局领域和情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！为应对未来更加复杂的市场变化，公司持续积极开拓海外市场。目前在欧洲市场进展良好，产品送测认证至电动工具、车载充电机、工业电源、工业控制、家电、工业照明等领域，并实现了批量出货。除欧洲市场之外，公司开始开拓北美及东南亚市场，致力于发展全球客户。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题十二：公司 TGBT 在 12 寸的研发投产情况如何？12 寸核心规格料号产品是否已经可以批量？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司 TGBT 在 12 英寸工艺制程的研发及扩产顺利进行，利用 12 英寸先进工艺持续提升产品一致性，12 英寸核心规格料号产品具备批量生产能力。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单	无

日期	2023 年 11 月 16 日
----	------------------